

苏州日月新半导体有限公司
IC 产品封装测试生产扩建项目
调试日期公示

我公司依照建设项目环保审批意见和环境影响报告表的要求，于 2016 年 12 月完成 IC 产品封装测试生产扩建项目，于 2018 年 10 月完成优化配套环保设施施工，现依照建设项目竣工环境保护验收暂行办法规定公示苏州日月新半导体有限公司 IC 产品封装测试生产扩建项目调试日期，我公司已委托苏州工业园区中新清城环境发展有限公司对各项污染物进行监测，并委托有资质的环境保护专家对监测方案进行评审，编制验收报告并出具专家评审意见，我公司在试运行期间确保主体工程调试工况稳定，环境保护设施在正常生产的情况下进行，并如实记录检测时的实际工况，现对调试时间进行公示。

调试日期为 2016 年 12 月至 2018 年 10 月。

联系人:王德翠

联系电话: 18662290018

公示日期:2019-01-15

